「2026 年度版　実装技術ロードマップ」

発刊および報告会のご案内

一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)、電子実装技術委員会／Jisso 技術ロードマップ専門委員会では、1999 年の初版発刊以来、隔年で実装技術ロードマップを刊行してきました。

本書は第 14 版となる「2026 年度版 実装技術ロードマップ」であり、我が国の実装技術の現状と将来像を体系的に整理した最新の技術指針です。

本書では、ポストコロナ社会への移行、地政学リスクの顕在化、生成 AI の急速な普及、データセンター需要の拡大、モビリティの電動化・知能化など、エレクトロニクス産業を取り巻く大きな環境変化を踏まえ、2035 年頃を見据えた実装技術の方向性を展望しています。
特に、AI 社会を支える「Jisso 技術」を中核テーマとし、高速通信、先端パッケージング、プリント配線板、実装設備などの技術動向を幅広く解説しています。

また、2026 年度版では、市場・アプリケーション起点での分析をさらに深化させ、「情報通信」「モビリティ」「メディカル・ライフサイエンス」「新技術・新市場」の 4 つの重点分野を対象に、今後の成長領域と必要となる実装技術を整理しています。加えて、電子デバイスパッケージ分野では Chiplet や BSPDN、プリント配線板分野では海外ロードマップとの比較、実装設備分野では半導体実装設備を初めて取り上げるなど、最新の産業動向を反映した内容となっています。

本ロードマップは、電子機器メーカー、材料メーカー、装置メーカー、研究機関、大学関係者など、実装技術に関わる幅広い方々にとって、今後の技術戦略・研究開発・標準化活動の指針となる一冊です。

また、「2026 年度版実装技術ロードマップ」発刊に伴い、本冊子の内容をより深めていただくことを目的として、ご購入いただいた方を対象に、報告会を開催いたします。
関係各所等に広く周知いただき、多くの皆様のご参加を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

■刊行物　：　「2026 年度版　実装技術ロードマップ」

■編集・発行：　一般社団法人 電子情報技術産業協会
電子実装技術委員会／Jisso 技術ロードマップ専門委員会

■体　裁　：　A4 判（528 ページ、約 100MB）

■頒布価格　：
【PDF 版】
22,000 円（会員）
44,000 円（会員外）

【冊子＆PDF 版】 *2026 年 6 月 15 日までの期間限定頒布
33,000 円（会員）
55,000 円（会員外）

■購入サイト：　https://www.jeita.or.jp/japanese/public/

「2026年度版　実装技術ロードマップ」完成報告会のご案内

主催　一般社団法人 電子情報技術産業協会
協賛　一般社団法人 エレクトロニクス実装学会

「2026 年度版　実装技術ロードマップ」の発刊に伴い、本冊子の内容をより深くご理解いただくことを目的として、ご購入者様を対象に、下記の通り報告会を開催いたします。

■日　時　：　2026年6月9日(火)10:00～16:50

■会　場　：　東京ビッグサイト　会議棟　6F「605＋606会議室」

■プログラム　：　次ページに記載

■申込方法　：　「2026年度版　実装技術ロードマップ」をご購入いただいた方のみご参加頂けます。
（参加費無料）
■購入サイト：
https://www.jeita.or.jp/japanese/public/

＝＝＝**【参加方法】**＝＝＝
ご購入頂きました方に送付される「購入申込メール」内に申込方法の記載がございます。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

■申込期限　：　2026年6月5日(金)
※会場の収容人数(200 名)に達し次第、「会場参加」の受付を終了いたします。

■問合先　：　一般社団法人　電子情報技術産業協会
標準化センター（澤田・三武）
問合せフォーム：https://www.jeita.or.jp/japanese/contact/

「2026 年度版　実装技術ロードマップ」完成報告会　プログラム
司会：　岩瀬　鉄平　 Jisso 技術ロードマップ専門委員会　副委員長／パナソニックホールディングス（株）

第１部：　はじめに	
10:00～ 10:10	**●全体概略**　Jisso 技術ロードマップ専門委員会　委員長 西村　隆　　三菱電機（株）
第２部：　特別講演①	
10:10～ 10:40	**●「経済産業省における標準化政策の動向」** 経済産業省 イノベーション・環境局　国際電気標準課長　小太刀　慶明　氏
第３部：　注目される市場と電子機器群	
10:40～ 12:25	**●イントロダクション**　依田　智子　（株）日立製作所 **●情報通信**　谷本　琢磨　AKKODiS コンサルティング（株） **●モビリティ**　西村　隆　三菱電機（株） **●メディカル・ライフサイエンス**　杉崎　吉昭　（株）東芝 **●新技術・新材料・新市場**　宮原　将章　京セラ（株）
休憩（昼食）	
第４部：　半導体パッケージング技術	
13:25～ 14:25	**●AI・深層学習を牽引するポストムーア時代の半導体パッケージング技術** 尾崎　裕司　Semicon RobusSearch
第５部：　プリント配線板	
14:25～ 14:55	**●プリント配線板のパラダイムシフトへの対応** 宇都宮　久修　インターコネクションテクノロジーズ（株）
第６部：　実装設備	
14:55～ 15:25	**●実装設備における技術動向**　前田　憲　パナソニック　コネクト（株）
休憩	
第７部：　特別講演②	
15:10～ 16:45	**●「半導体デバイスの進化を担う常温・低温接合技術の最新動向」** 東北大学　大学院工学研究科　電子工学専攻　教授 一般社団法人エレクトロニクス実装学会（JIEP）　会長 IEEE EPS BOG メンバ　日暮　栄治　氏
閉会	
16:45～ 16:50	**●閉会挨拶**　Jisso 技術ロードマップ専門委員会　委員長 西村　隆　三菱電機（株）

※プログラム、発表者、時間については、事前の予告なく変更する場合があります。
　あらかじめご了承ください。
※進行状況により、各プログラムの時間が前後する可能性があります。